

『Beyond5G／ポストコロナ社会に向けてのエレクトロニクス実装技術』

(一社)エレクトロニクス実装学会関西支部では、「Beyond5G／ポストコロナ社会に向けてのエレクトロニクス実装技術」と題するテーマで第17回技術講演会をオンラインで開催致します。本講演会では、次世代高速通信・Beyond5G、さらには、新たな生活様式・ニューノーマルが求められるこれからの社会に向けての抗菌技術、非接触技術などを、実装技術の観点から著名な講師に専門的な立場でご講演頂きます。

本技術講演会を通じて、次の開発やビジネスのきっかけにして頂ければと考えます。多くの方々のご参加をお待ちしております。

- ・日時 : 2020年12月18日(金) 12:50~17:10
- ・開催方式 : Zoom Webinar 利用、聴講方法は、申し込み後に、別途連絡します。
- ・主催 : エレクトロニクス実装学会 関西支部
- ・協賛 : 日本電子回路工業会(JPCA)、表面技術協会関西支部、応用物理学会関西支部、高分子学会関西支部、電気学会関西支部、日本接着学会関西支部、スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会、近畿化学協会エレクトロニクス部、日本繊維機械学会、化学工学会エレクトロニクス部会、大阪府立大学 ものづくりイノベーション研究所、電子情報通信学会 電子部品・材料研究専門委員会(含予定)

プログラム

- ・12:30 Zoom Webinar オープン

- ・12:50-13:00 開会挨拶・諸連絡

- ・13:00-14:00 基調講演「Beyond5G／ポストコロナの社会経済を牽引するエレクトロニクス実装技術(仮)」
株式会社産業タイムズ社 泉谷 渉 氏

- ・14:00-14:10 休憩

- ・14:10-14:50 技術講演1 「空中ディスプレイの基礎と最新動向および今後の展望」 宇都宮大学 山本 裕紹 氏

- ・14:50-15:30 技術講演2 「紫外線Care222によるウイルス不活化技術について」 ウシオ電機株式会社 平尾 哲治 氏

- ・15:30-15:45 休憩

- ・15:45-16:25 技術講演3 「界面化学反応に着目した銅系導電性ペーストの材料設計」 群馬大学 井上 雅博 氏

- ・16:25-17:05 技術講演4 「厚み方向800W/m²・K 高熱伝導部材 Zebro/ジプロの紹介」
株式会社昭和丸筒 外谷 栄一 氏

- ・17:05-17:10 閉会挨拶・終了

* 定員120名(先着申込順)

* 参加費「クーポン利用可:1名/枚」

会員/賛助会員/協賛学会会員:5,000円 シニア会員:2,000円 非会員:12,000円 学生会員:1,000円
一般学生:2,000円

・税込、参加申込み受付後、振込先をお知らせします。

* 申し込み締め切り:2020年12月14日(月)

・ご参加の方は関西支部 HP (<https://web.jiep.or.jp/kansai/event.html>) からご登録ください。

・この機にエレクトロニクス実装学会への入会を希望される方は、その旨明記の上お申込み下さい。

問合せ:エレクトロニクス実装学会関西支部事務局 lecturer-kansai@jiep.or.jp(技術講演会専用)にご送付ください。